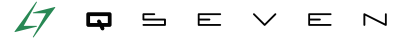
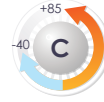
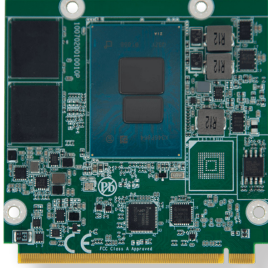


EmQ-iX702



Intel® Amston Lake 处理器 Qseven R2.1 CPU 模块



特 点

- 板贴 Intel Amston lake SoC 处理器
- 板贴 LPDDR5 4GB/8GB/16GB SDRAM
- 集成千兆网控制器
- 双通道 24-bit LVDS 和 1 x DDI 接口
- 符合 Qseven 规范标准 2.1 版

系统

CPU	板贴 Intel® 凌动® x7211RE 1.0GHz/3.2GHz (Turbo) 双核 TDP 6W 凌动® x7433RE 1.5GHz/3.5GHz (Turbo) 四核 TDP 9W
内存	板贴 LPDDR5 4800MT/s 4GB / 8GB / 16GB
BIOS	AMI UEFI BIOS
TPM	支持 TPM 2.0

I/O

USB 接口	6 x USB 2.0 接口 2 x USB 3.2 接口
串口	1 x UART
扩展总线	4 x PCIe1 Gen3 通道, I2C, SMBus, SPI
存储	2 x SATA 3.0 接口 板贴 eMMC 5.1 (OEM 需求)
网络芯片	1 x Intel® i210 网络控制器
音频	HD link

显示

显示芯片	集成于 Intel® Gen12 核显
显示接口	双通道 24-bit LVDS, 最高分辨率 1920x1200 1 x DDI 接口 支持 HDMI 2.0b 或 DP1.4 或 eDP1.4b 最高分辨率 4096x2304@60HZ

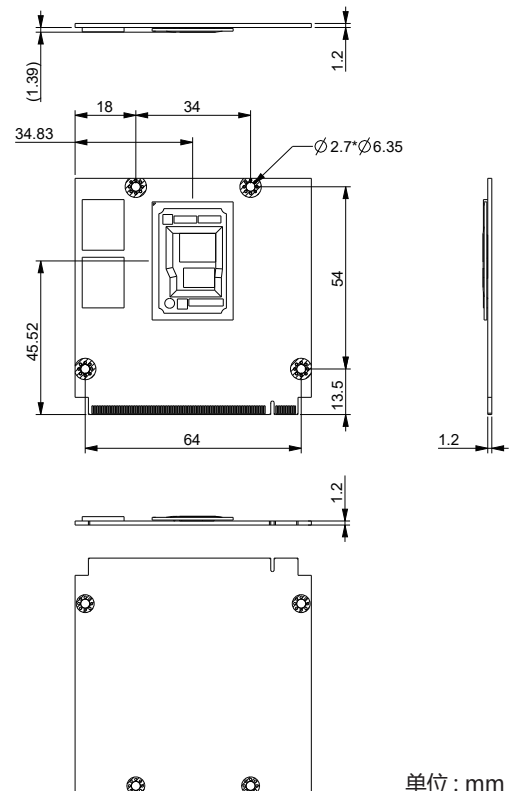
支持操作系统

Windows 10/11 64-bit
Linux: Ubuntu

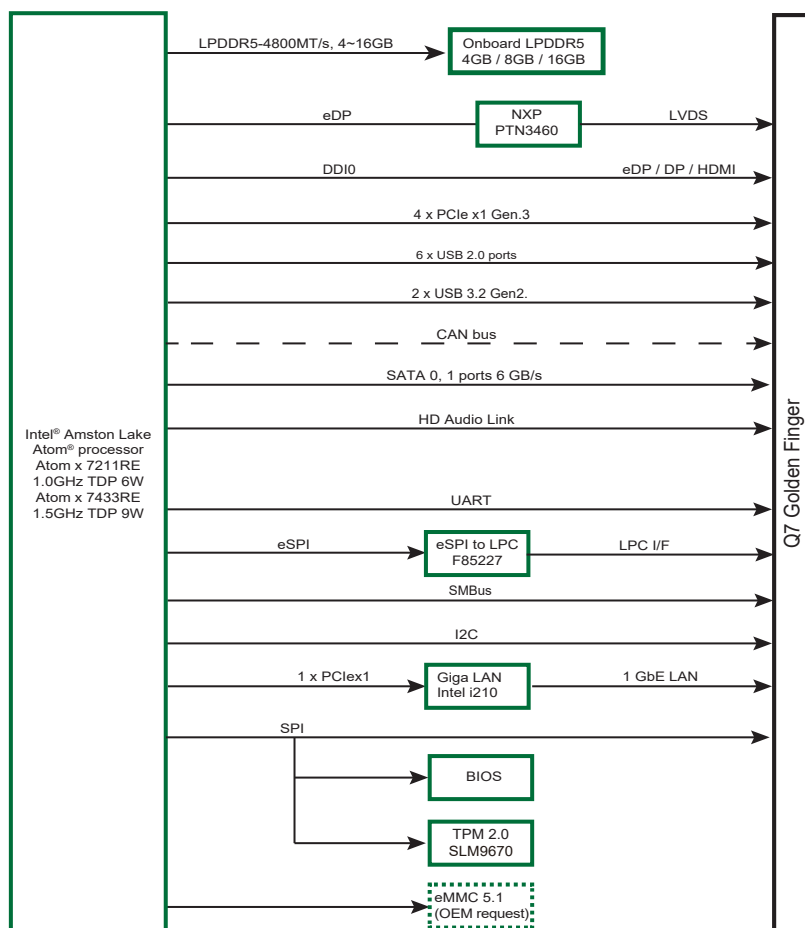
机构与环境

电源需求	DC 5V, 5VSB
工作温度	-40 ~ 85°C (-40~185°F)
工作湿度	10 ~ 95% @ 85°C (无冷凝)
尺寸 (L x W)	70 x 70 mm (2.76" x 2.76")

尺寸图



方框图



订货信息

EmQ-iX702-WT-x7211RE-4G Qseven R2.1 Intel® Amston Lake ATOM x7211RE CPU 模块带 4G 内存, -40~85°C

EmQ-iX702-WT-x7433RE-8G Qseven R2.1 Intel® Amston Lake ATOM x7433RE CPU 模块带 8G 内存, -40~85°C

可选配件

HS-X702-F1

导热器

PBQ-900R

Qseven R2.1 ATX 尺寸外型载版 (所有 Super IO 接口功能为 OEM 需求)

CBK-02-900R-00

线材